

技术参数

5663T

日期：03/2025

应用介绍

特点

一款单组份环氧树脂胶，加热固化，流平好等特点，具有较高耐候性及稳定可靠性能；适用于电子芯片及元器件底部填充及包封保护粘接。

粘接材料

金属，陶瓷，塑料/PCB，玻璃等

典型应用

电子元器件底部填充

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	黑色	
粘度(cps)	390	2rpm@25℃,ASTM D-1084
固化条件*	8mins@130℃	
有效期@-5℃，月	6	

*固化温度是指达到胶水表面的实际温度

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	黑色	
邵氏硬度	80D	ASTM D-2240
玻璃化温度 Tg	≥107℃	TMA
热膨胀系数	$\alpha_1=40\text{ppm}/^\circ\text{C}$ (<Tg) $\alpha_2=128\text{ppm}/^\circ\text{C}$ (>Tg)	

可靠性	数值	测试方法
固化失重	<1%	
工作温度范围*	-55℃—150℃	

储存和使用方法

产品需低于-5℃环境中保存，使用前请先移至室温解冻，30ml 或 55ml 包装至少回温 2 小时。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件。

注：

1. 本技术数据表（TDS）中提供的信息和应用建议是基于 TDS 更新日时，我们对本产品的了解和经验而编写，数据不作为质检标准。该产品有各种不同的应用，差异化的应用和工作环境会超出我们的控制范围，因此我们对产品的适用性不承担责任，强烈建议您在使用前做完整的产品和工艺匹配测试，并以此来评估确认该产品的适用性。
2. 本文档的内容可能会有更新，除非有明确的书面承诺，禧合没有义务通知客户关于内容的更改。

